

(주)넥스틴 2025년 2분기 실적리뷰

NEXTIN brings Competition into the Wafer Inspection Market !!!

2025. 8. 25

NEXTIN

ECRC
우수기업연구소
EXCELLENT CORPORATION R&D CENTER

강소기업
100
소재
부품
장비

NEXTIN

Disclaimer

이 자료는 해당 법률에서 허용하는 상황에서 정보 제공의 목적으로 사용됩니다. 이는 특정 투자 목적, 재정 상황 또는 수령인의 특별한 요구와 관련이 없습니다. 본 자료는 향후 정보 제공의 목적으로만 제공되었으며 본 자료의 복사, 복제, 재배포는 금지되어 있습니다.

본 자료에 대한 재무 결과에는 현재 이용 가능한 정보에 비추어 주식회사 넥스틴의 가정과 기대를 나타내는 예측, 전망 및 기타 예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있는 진술입니다. 본 자료에 사용된 '예상하다', '추정하다', '의도하다', '기대하다', '~일 수도 있다', '계획하다' 등의 단어와 관련된 유사한 표현은 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다.

이러한 예측 등은 현재 시장 동향, 회사 경영 등에 기초한 것입니다. 실제 결과는 실질적으로 긍정적이거나 부정적인 방식으로 달라질 수 있습니다. 예측은 주식회사 넥스틴의 통제 범위를 벗어난 불확실성과 우발적 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 본 자료에 표현된 모든 의견은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

대표자 및 임직원은 이 자료의 전부 또는 일부를 사용함으로써 발생하는 손실이나 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 자료는 유가증권이나 관련 금융 상품을 매수 또는 매도하도록 권유하거나 제안하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 수신자는 이 자료의 전부 또는 일부를 자신의 판단을 대신하는 것으로 간주해서는 안 됩니다.



CONTENTS

I. 회사소개

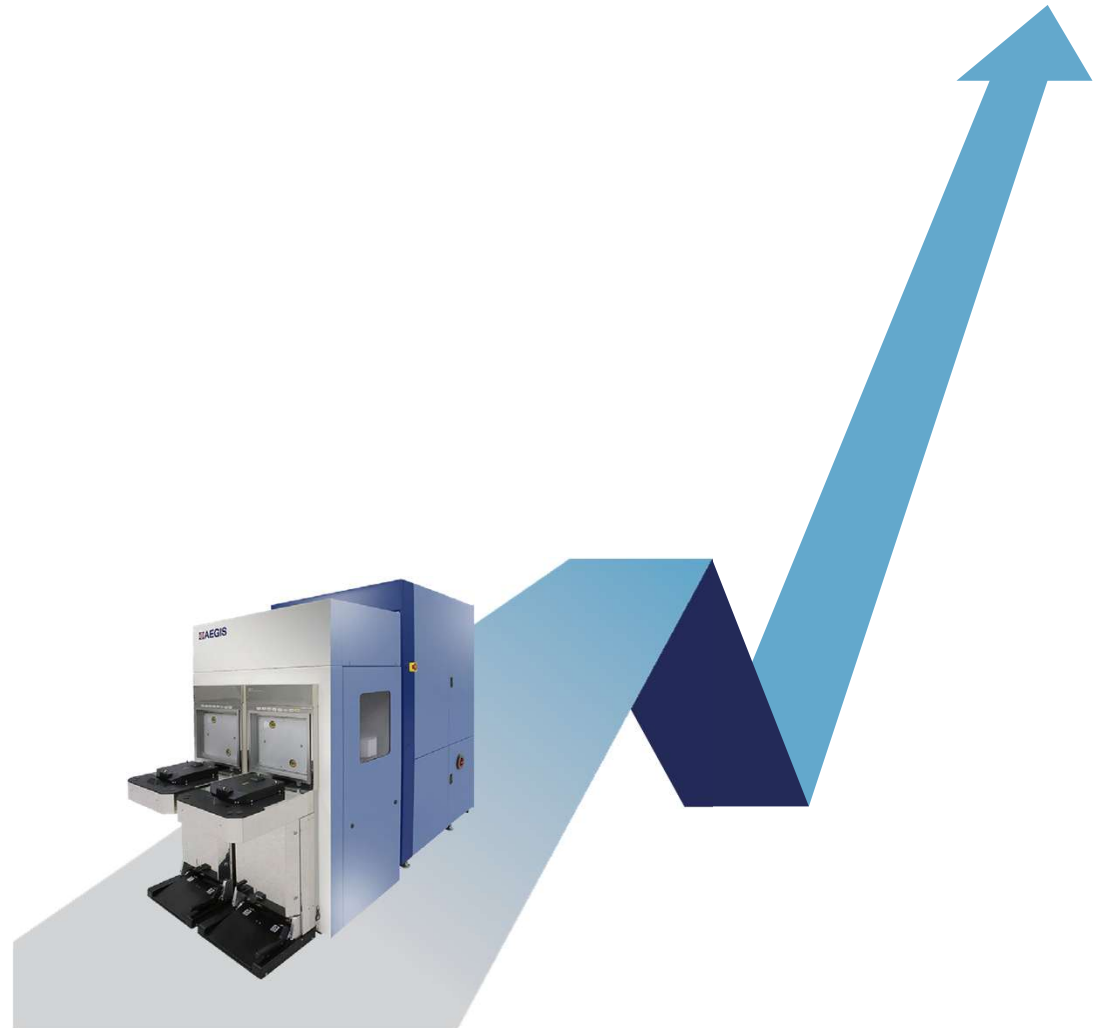
II. 사업현황

III. 실적리뷰

IV. 신규사업

V. 증장기 사업 전략

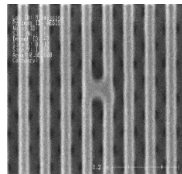
- 맺음말
- Appendix



What is semiconductor inspection equipment?

Optical
Inspection
System

반도체 소자의 회로 제작 과정의 패턴 불량 발생 확인



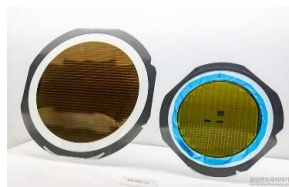
NEXTIN



반도체 검사 장비

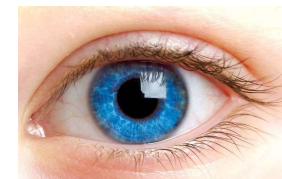
Electrical
Tester

반도체 소자의 회로 제작 완료 또는 패키지 제작 완료 후 전기적 작동 확인



Machine
Vision

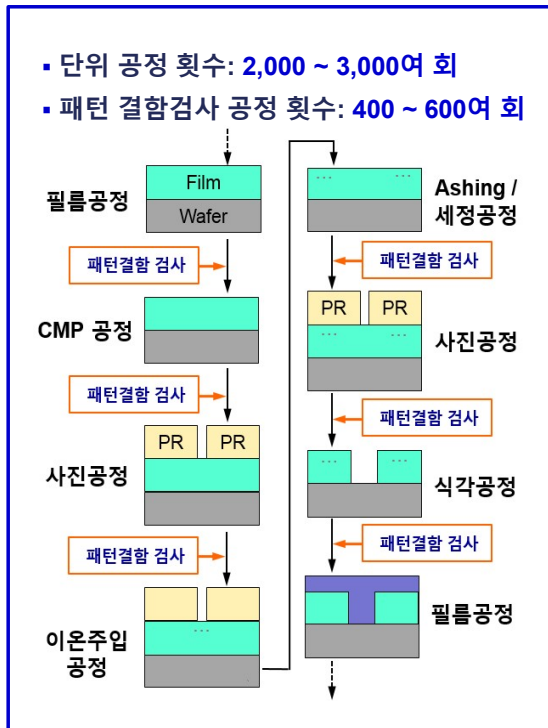
반도체 소자의 패키지 제작 완료 후 외관의 불량 발생 확인



반도체 패턴 결함 검사 공정 및 중요성

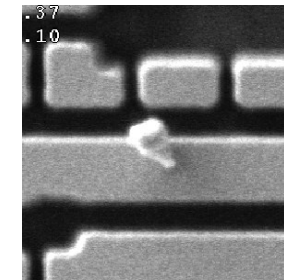
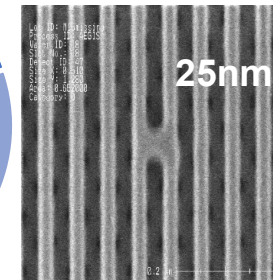
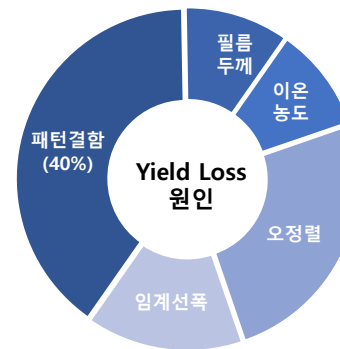
■ 반도체 미세화에 따라 공정 난이도 증가하여 수율 저하 초래

- 공정 불량률의 최대 원인은 패턴 결함과 이물(Particle)의 발생 : **약 40%**
- 패턴 결함과 이물의 발생은 사전 예정에 어려움이 있어 **실시간 관리가 필수적임**



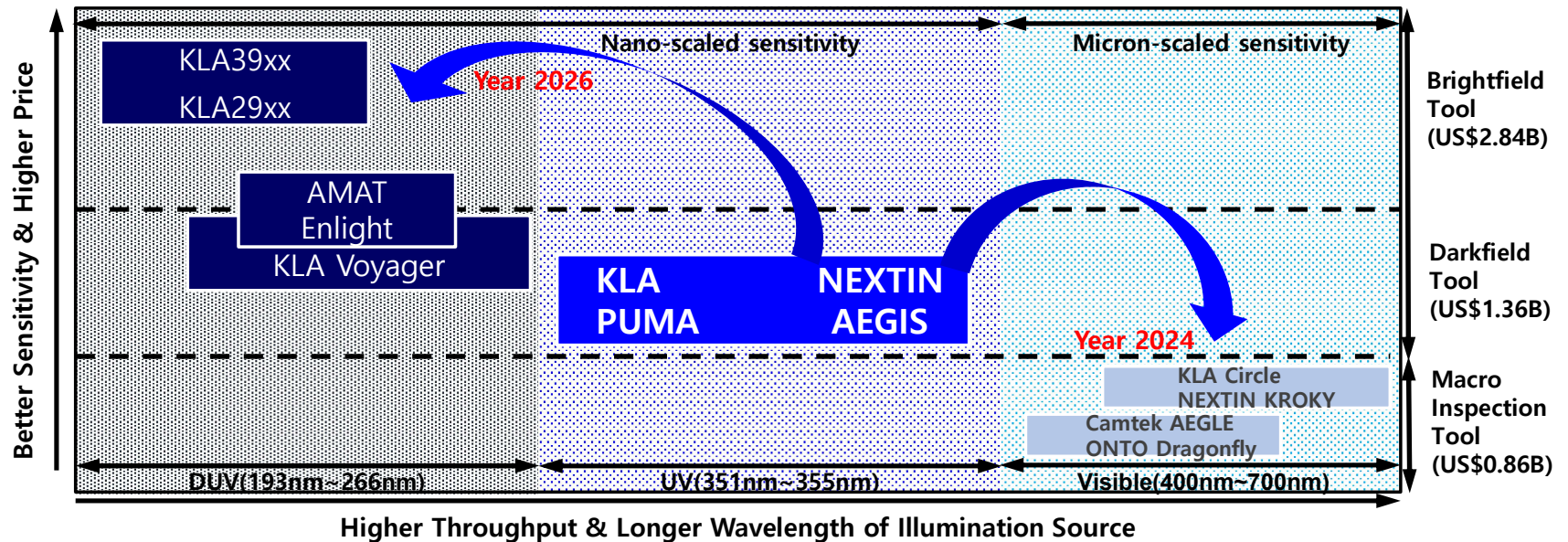
반도체 소자업체의 패턴 결함 검사 장비의 활용

- R&D: Defect-free **신규 공정의 개발**
- Production: **생산 수율 관리** 및 생산량 예측



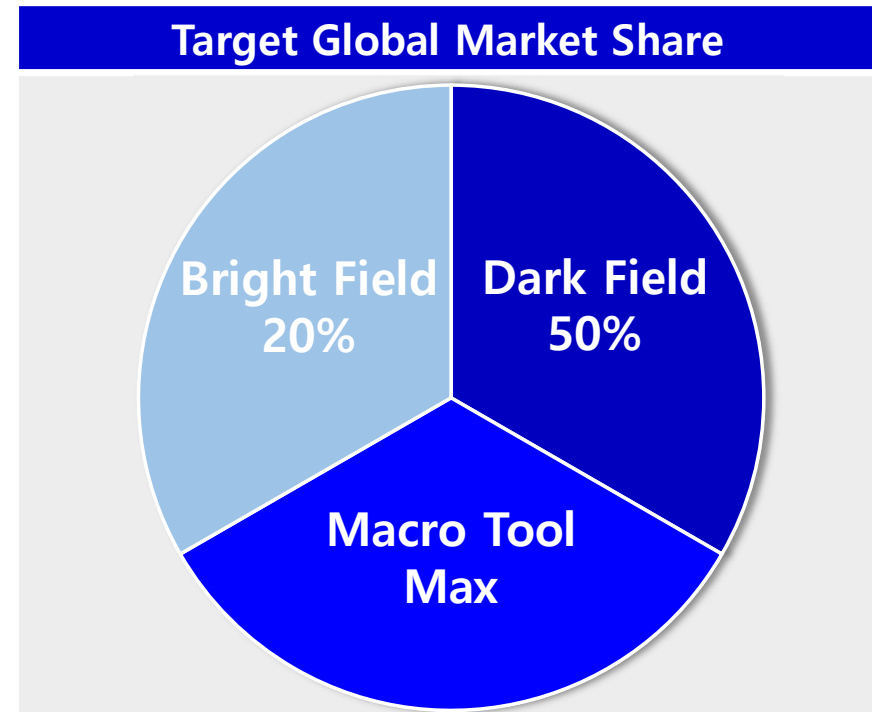
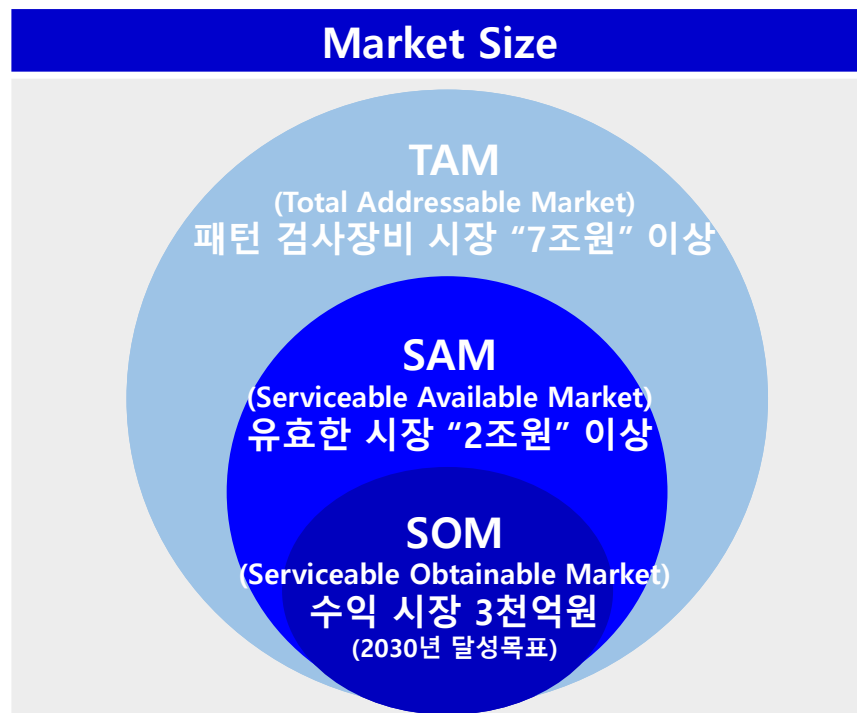
광학 패턴 결함 검사 장비의 분류

광학 패턴 결함 검사 장비: Mix-and-Match Solution(검출감도 & 검사속도)



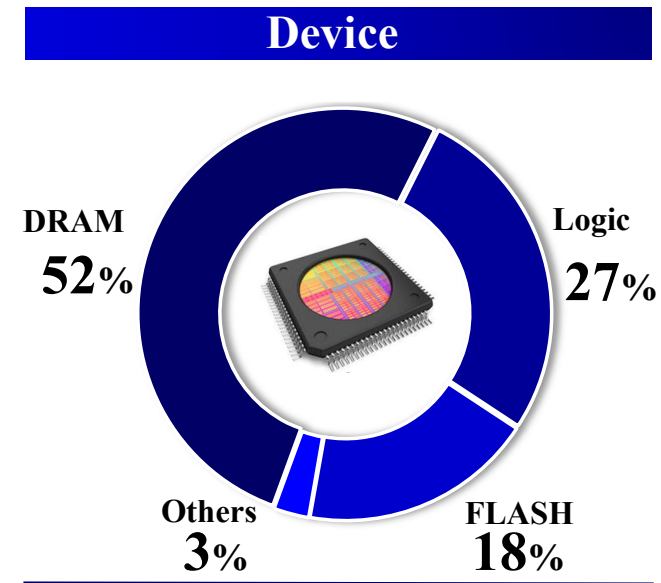
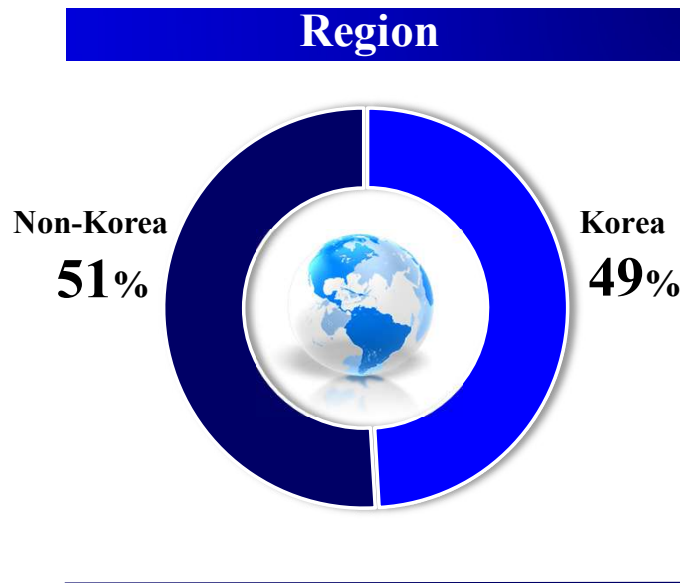
Market Analysis

- 확대되는 글로벌 시장 기회, 강화되는 성장 모멘텀



Well Balanced Portfolio

■ Cumulated Install Base (25.06.30) – 25년 1분기 대비 국내향 7%, DRAM향 5% 상승



■ Diversified Customer



What we make

■ Product Portfolio – 2025년 대폭 확장된 제품 라인업으로 성장 동력 확보

- HBM 맞춤형 검사장비 KROKY 성공적 출시 및 KROKY 라인업 확장
- Advanced Packaging 도래에 따른 차세대 장비 개발 착수

Front end Inspection



AEGIS-IV

(Under development)

Bright Field
Inspection

DUV

(Under development)

HBM Metrology & Inspection



KROKY-W

(Pre-dicing wafer-level inspection)



KROKY-R

(Post-wafer dicing inspection)



KROKY-M

(Under development)

Chiplet & HBM Inspection



AEGIS



ASPER

(Under development)



KROKY-R

3D Nand & 3D Process



IRIS-II

(Nand Front end inspection)

Electrostatic Charge Removal



ResQ

(Under development)

Hybrid bonding Inspection

X-ray
Inspection

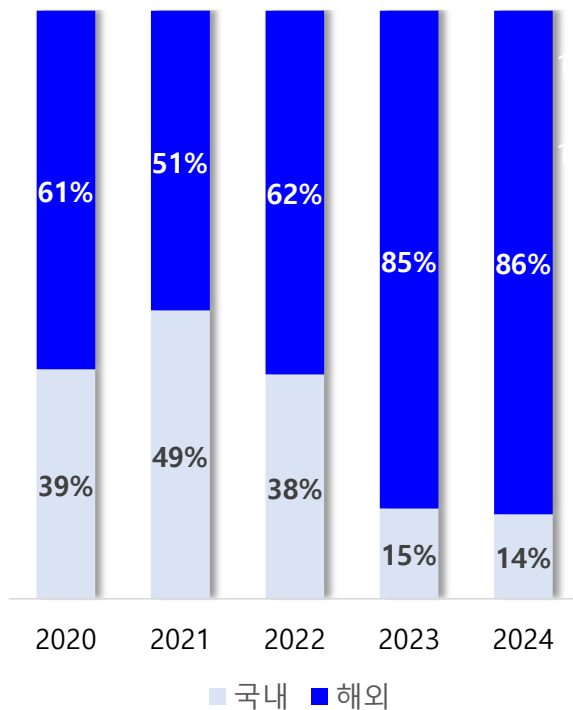
NeXray

(Under development)

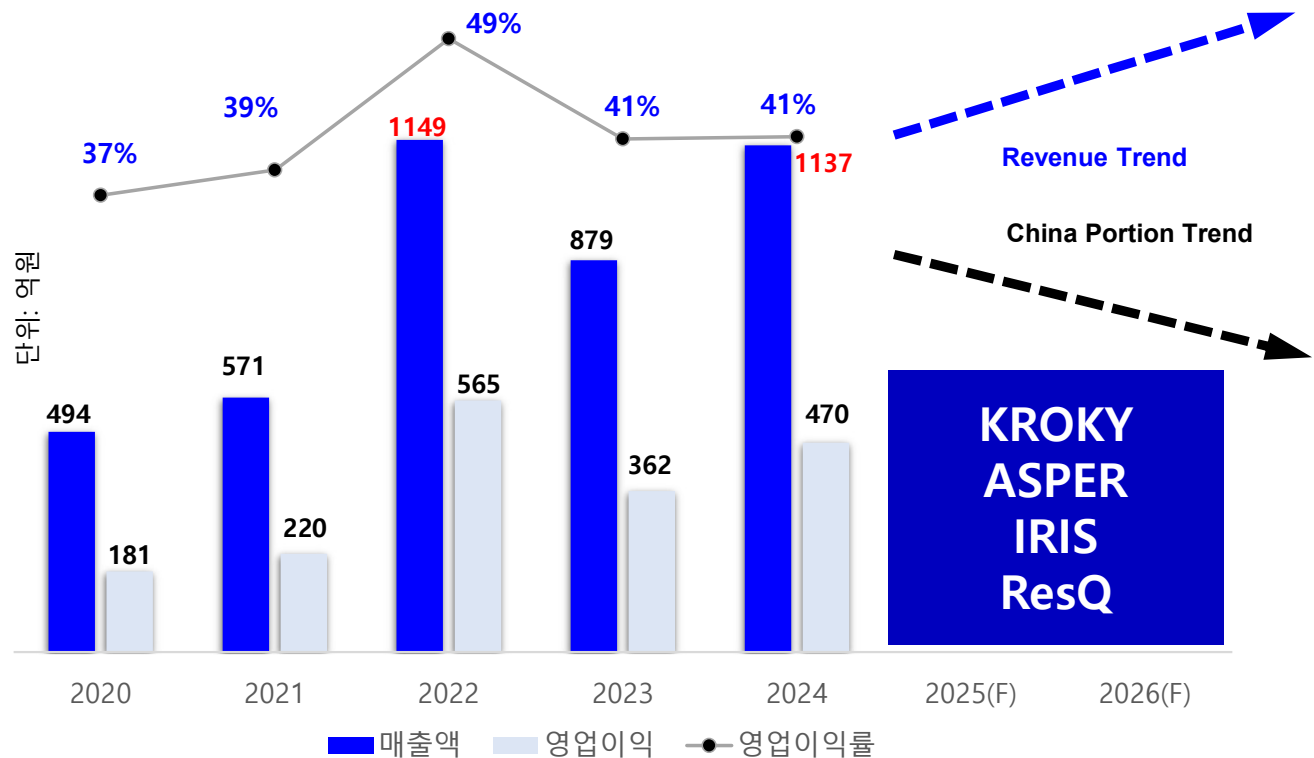
Revenue & Profit Trend

■ 포트폴리오와 글로벌 고객 다변화를 통한 안정적 성장과 매출 극대화

1) 지역별 매출 비중



2) 매출액 & 영업이익 & 영업이익률



2Q25 Revenue & Profit

■ 분기별 연결손익 기준

1) 분기별 실적비교

(단위: 백만원)

	2Q24	1Q25	2Q25	QoQ	YoY
매출액	14,749	17,084	23,159	35.6%	57.0%
매출 총이익	10,003	10,722	9,475	(11.6%)	(5.3%)
매출 총이익률	67.8%	62.8%	40.9%	(21.9%p)	(26.9%p)
판매와 관리비	9,582	7,310	6,897	(5.7%)	(28.0%)
영업이익	421	3,412	2,578	(24.4%)	512.5%
영업이익률	2.9%	20.0%	11.1%	(8.9%p)	8.2%p

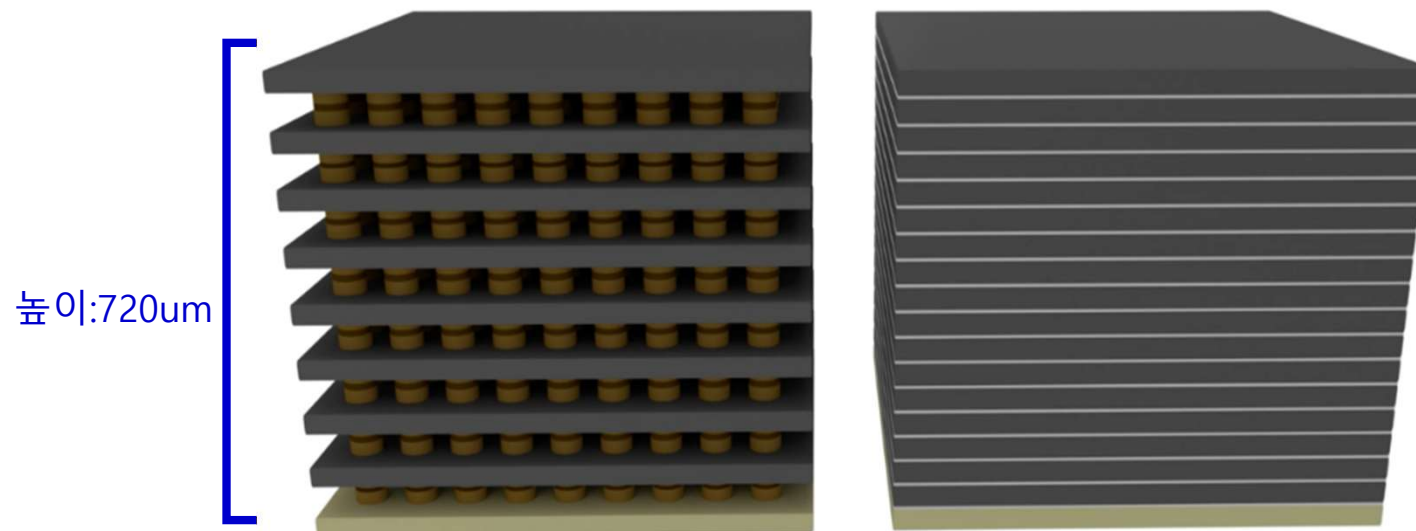
2) '25년 반기 매출액 세부내역

매출액	국내	해외
1Q	7,070	10,013
2Q	21,643	1,516
계	28,713	11,529
비중	41%	59%
	93%	7%

New Business "X-ray Inspection"

■ Hybrid Bonding이 필요한 이유

- Bump들이 사용하고 있는 Z-axis 공간을 chip으로 채우기 위함



COPPER PILLAR
INTERCONNECT TECHNOLOGY



8 HIGH

(출처 : SK하이닉스)

DBI® Ultra

16 HIGH

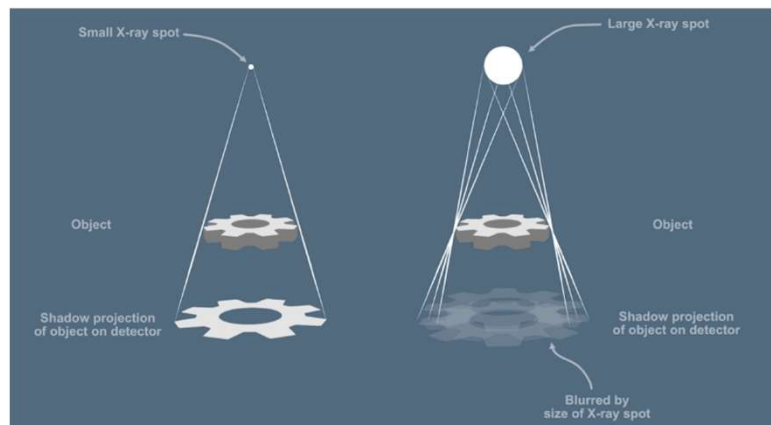
New Business "X-ray Inspection"

■ 기존 X-ray source 해상도 & T-put은 Trade off 관계 → Collimated source 적용을 통한 한계 극복

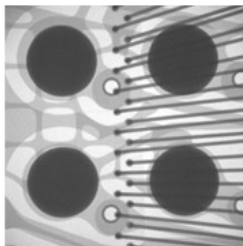
Conventional

Spot size vs. Resolution

- X-ray spot size is small → slow measurement time
- X-ray spot size is large → blurred image



- $2\mu\text{m}$ resolution



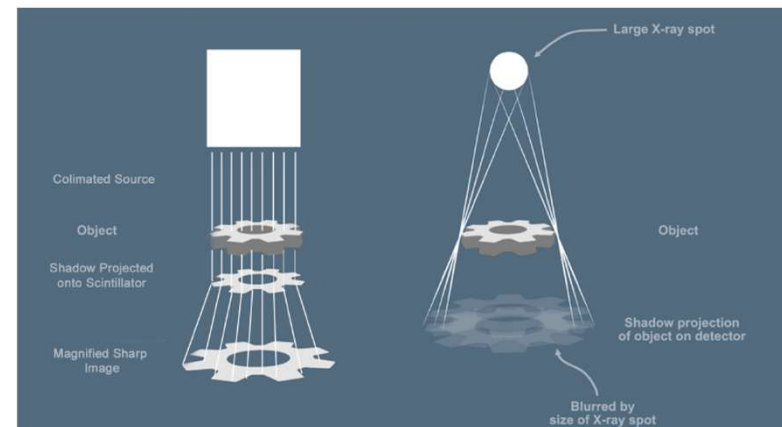
- $20\mu\text{m}$ resolution



NeXray

Collimated X-ray

- Collimated X-ray (2D)
→ fine focused image & fast measurement time



- Advanced Performance

Conventional		NeXray	
FOV	Resolution	FOV	Resolution
1mm x 1mm	2 μm	10mm x 13mm	0.7 μm
		23mm x 17mm	1.3 μm

국내외 생산기반 확대

- 동탄 산단
- 용인 반도체 클러스터
- NAKEXIN (Wuxi)

제품의 다각화

- AEGIS, DUV, IRIS, ASPER , KROKY(R,W,M), NeXray
- RESQ

사업전략

수요처의 다변화

- Device업체, 디스플레이업체
- 재료업체, 장비업체

해외 거점의 확대

- 중국(생산), 일본(영업)
- 미국, 유럽, 싱가포르

NAKEXIN @ 2025. 10

■ 중국 현지 생산기지 완공 및 정상가동 본격화



■ 목적

: 지정학적 불확실성 해소와 현지화 전략을 통한 이익 극대화

■ 위치

: 중국 장쑤성 우시시 신우구 시센로

■ 크기

: 7200 평

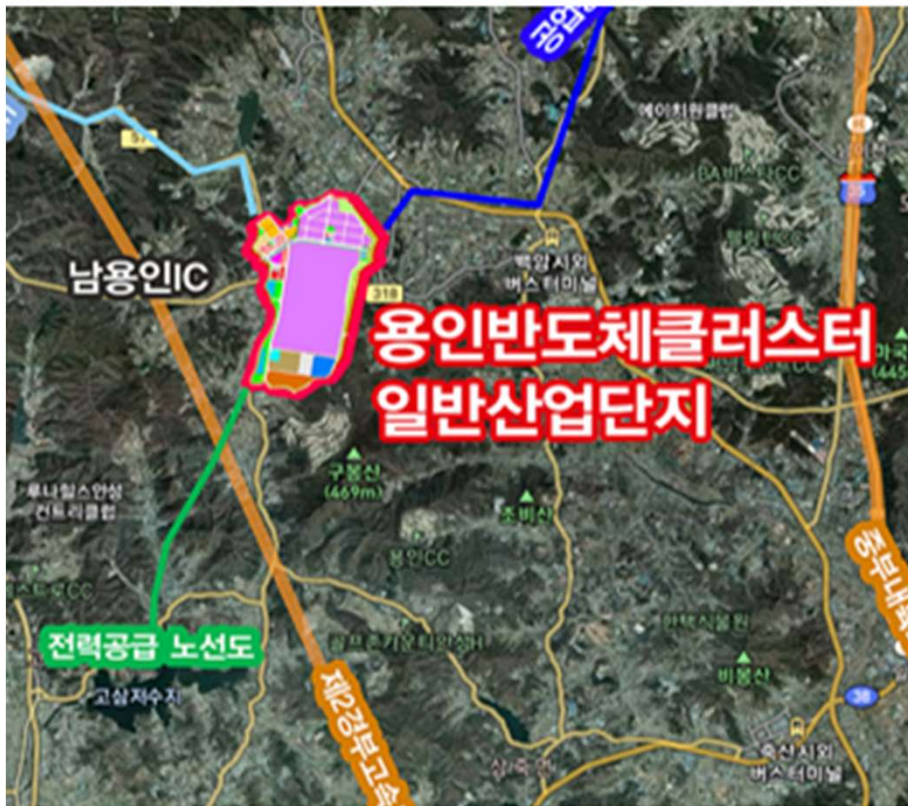
■ 주요 일정

- 1) 2024년 착공
- 2) 2025년 준공

용인반도체클러스터

■ 추가 Capa 확보 필요에 따라 용인 반도체클러스터에 신규 공장 및 R&D센터 건축 추진

용인반도체 클러스터 일반산업단지



■ 목적

: 다양한 제품군 개발 진행으로 추가 Capa 필요

■ 위치

: 경기도 용인시 처인구 원삼면 산업단지

■ 크기

: 건축 14,890(평), 토지 4,256(평)

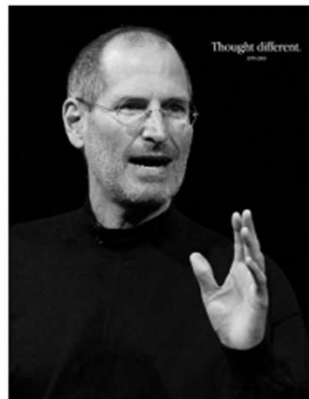
■ 주요 일정

- 1) 2023년 반도체클러스터 입주기업 선정
- 2) 2026년 설계 완료
- 3) 2027년 토지대금 완납
- 4) 2027년 착공
- 5) 2028년 준공

KLA가 시장을 개척했고, NEXTIN은 점유율 확대 중

- 애플은 휴대폰 시장의 패러다임을 바꾸며 스마트폰의 시대를 창출
- 삼성은 그 뒤를 빠르게 추격하며, 현재는 시장 점유율 1위를 차지
- KLA는 웨이퍼 결함 검사 분야에서 기술 혁신을 선도하며 새로운 기준을 제시
- 넥스틴(NEXTIN)은 후발주자로 시장에 진입하여, 시장 내 입지를 확대하는 중

 Apple



 SAMSUNG



리워너는 웃으며 출근하고
가족은 자랑스레워 하는

감사합니다.
Q&A

For more information contact:

Investor Relations

ir@nextinsol.com

031-629-2353

